

证券代码：002005

证券简称：德豪润达

编号：2018—92

广东德豪润达电气股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）36,832 万股，每股发行价 5.43 元，募集资金总额为人民币 1,999,977,600.00 元，扣除发行费用人民币 30,877,753.96 元后，实际募集资金净额为人民币 1,969,099,846.04 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 19 日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10698 号《验资报告》验证。

本公司已将募集资金人民币 492,274,961.51 元增资至大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪”），截至 2017 年 11 月 8 日止，大连德豪实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第 10087 号验资报告验证确认。

本公司已将募集资金人民币 1,476,824,884.53 元增资至蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称“蚌埠三颐”），截至 2017 年 11 月 8 日止，蚌埠三颐实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第 10086 号验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况和结余情况

本次募集资金净额人民币 1,969,099,846.04 元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入的金额为人民币 190,184,250.20 元，其中：LED 芯片级封装项目累计投入 12,830,000.00 元，LED 倒装芯片项目累计投入 177,354,250.20 元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 900,000,000 元。截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 891,925,898.67 元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币 13,010,302.83 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户管理制度。

（二）三方监管情况

根据管理制度，公司于 2017 年 11 月与平安银行股份有限公司珠海分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

公司之子公司大连德豪于 2017 年 11 月分别与大连银行股份有限公司第三中心支行、中国银行股份有限公司大连金普新区分行、中信银行股份有限公司大连分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

公司之子公司蚌埠三颐于 2017 年 11 月分别与平安银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

（三）募集资金专户存储情况

2017 年 10 月 19 日，本公司在平安银行股份有限公司珠海分行（账号：15123451234526）募集资金专户收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币 1,969,099,846.04 元以及当时尚未支付的发行费用人民币 1,632,470.95 元。

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

单位名称	银行名称	账号	募集资金余额	备注
广东德豪润达电气股份有限公司	平安银行股份有限公司珠海分行	15123451234526	329,239.85	LED 倒装芯片项目、LED 芯片级封装项目
大连德豪光电科技有限公司	大连银行股份有限公司第三中心支行	800601209006744	364,911.73	LED 芯片级封装
大连德豪光电科技有限公司	中国银行股份有限公司大连金普新区分行	302574671054	31,742,098.94	LED 芯片级封装
大连德豪光电科技有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	8110401014000360593	459,616.74	LED 芯片级封装
蚌埠三颐半导体有限公司	平安银行股份有限公司合肥分行	15168968968999	152,734,831.51	LED 倒装芯片项目
蚌埠三颐半导体有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	20000443201510300000091	105,199.90	LED 倒装芯片项目
蚌埠三颐半导体有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	20000443201510300000106 协定存款户	706,190,000.00	LED 倒装芯片项目
合计			891,925,898.67	

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 891,925,898.67 元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币 13,010,302.83 元）。

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 11 月 27 日止，募集资金投资项目 LED 倒装芯片项目先期投入金额人民币 93,982,612.25 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 1 日出具信会师报字[2017]第 ZC10718 号《关于广东德豪润达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。

2017年12月1日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见、本次以募集资金置换先期投入履行了必要的审批程序。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司使用闲置募集资金90,000万元暂时补充了流动资金。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已于公司于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2018 半年度

单位：人民币万元

募集资金总额	196,909.98					本年度投入募集资金总额	8,337.17			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	19,018.43			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. LED 芯片级封装	否	49,227.50	49,227.50	0	1,283.00	2.61%	不适用	不适用	不适用	否
2. LED 倒装芯片项目	否	147,682.48	147,682.48	8,337.16	17,735.43	12.01%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		196,909.98	196,909.98	8,337.16	19,018.43	9.66%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	LED 芯片级封装项目在报告期内使用募集资金投入 0 万元，使用自有资金投入 6,096.98 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额	不适用									

额、用途及使用 进展情况	
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	募集资金投资项目 LED 倒装芯片项目先期投入金额人民币 9,398.26 万元，经公司第五届董 事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 90,000 万元，经公司第五届董事会第三十四会议、 第五届监事会第十九次会议审议并通过。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额 89,192.59 万元，后续用于投入 LED 倒装芯 片项目、LED 芯片级封装项目。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无